



平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成31年2月12日

上場取引所 東

上場会社名 アピックヤマダ株式会社
 コード番号 6300 URL <http://www.apicyamada.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 押森広仁
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役企画部長 (氏名) 小出 篤 TEL 026-275-2111
 四半期報告書提出予定日 平成31年2月13日 配当支払開始予定日 ー
 四半期決算補足説明資料作成の有無：無
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年3月期第3四半期	6,562	△16.4	△549	—	△536	—	△534	—
30年3月期第3四半期	7,849	14.8	△92	—	△102	—	△292	—

(注) 包括利益 31年3月期第3四半期 △625百万円 (ー%) 30年3月期第3四半期 △239百万円 (ー%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
31年3月期第3四半期	△43.07	—
30年3月期第3四半期	△23.55	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
31年3月期第3四半期	11,862	3,196	26.9
30年3月期	11,049	3,821	34.6

(参考) 自己資本 31年3月期第3四半期 3,196百万円 30年3月期 3,821百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
30年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
31年3月期	—	0.00	—	—	—
31年3月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 平成31年3月期の連結業績予想（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	10,000	△21.0	△440	—	△420	—	△460	—	△37.04

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

連結業績予想の修正については、平成31年2月12日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 一社 （社名） 、除外 一社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	31年3月期3Q	12,969,000株	30年3月期	12,969,000株
② 期末自己株式数	31年3月期3Q	549,574株	30年3月期	549,573株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	31年3月期3Q	12,419,426株	30年3月期3Q	12,419,427株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手できる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績の予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 2「1. 当四半期に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	9
(参考資料)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年2月16日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態に関する説明については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間（平成30年4月1日～平成30年12月31日）における世界経済は、総じて底堅く推移しましたが、米中の貿易戦争の激化などが世界経済を下押しし、景気の不確実性を高めるリスクが増大しています。

こうした環境の中で、当社グループの主な供給先である半導体業界においては、半導体需要の旺盛な需要を背景に総じて活況でした。しかしながら上期後半より、スマートフォン市場の減退や世界景気の減速懸念、メモリーの価格下落及び米中貿易戦争の懸念による先行きの不透明感から、半導体メーカーにおいては投資の先送りなど、投資の決定が遅れるという状況が続いており、景況感は大きく悪化してきています。

一方、自動車業界に関しては、自動車の高機能化による電子制御装置の増加や、電気自動車・ハイブリッド自動車の増加により、車載用センサー、インバーターなどの車載用半導体需要の拡大が継続しております。

当社においては、一般半導体向けはスマートフォン市場の減速、米中貿易戦争の激化等により、設備投資判断の先送りの影響が第3四半期に入り顕著となりました。結果、WLP（ウェハーレベルパッケージ）用コンプレッションモールド装置を含め先端向け装置や車載向け半導体製造装置の受注は対年同期と比べ増加をしていますが、第3四半期は一般半導体向けの落ち込みが大きく、総体では対前年に比較し受注の増加が止まってきております。また、売上も上期の納期遅れによる影響を当第3四半期連結累計期間でも挽回できず前期同期比で下回りました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は6,562百万円（前年同四半期比16.4%減）、営業損失は549百万円（前年同四半期は営業損失92百万円）、経常損失は536百万円（前年同四半期は経常損失102百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は534百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失292百万円）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①電子部品組立装置

電子部品組立装置の受注環境は、車載向け装置は車載用センサーやインバーター等の車載用半導体の需要拡大とともに、国内外とも引続き順調な動きとなりました。一方、一般半導体向けは第3四半期に入り前述のとおり受注環境が急激に悪化し、特に中国市場の悪化が顕著で、投資判断の先送り等が発生し、受注は第3四半期で比較すると対前年同期を下回りました。

また売上においても上期に発生した一部部材の調達難や設計のボトルネックの発生等による納期遅れの影響が解消できず、第4四半期に納期が集中する傾向が前年同期より顕著となっており、また顧客の一部に納期の先送りが出ていること等により売上及び利益ともに前年同期を下回りました。

この結果、売上高は5,248百万円（前年同四半期比21.3%減）、セグメント損失は65百万円（前年同四半期はセグメント利益355百万円）となりました。

②電子部品

車載向け製品が好調に推移したこと及び電子部品を製造していたタイ子会社の閉鎖により、売上は増加し赤字幅は縮小いたしました。

この結果、売上高は896百万円（前年同四半期比4.5%増）、セグメント損失は55百万円（前年同四半期はセグメント損失70百万円）となりました。

③その他

その他は、リード加工金型及びリードフレーム用生産金型の販売であります。リードフレームを使用する半導体の設備投資につきましてはマーケットが限られておりますが、車載向けの受注が好調に推移しましたが、新規開発製品が多かったことにより利益率は悪化しました。

この結果、売上高416百万円（前年同四半期比29.8%増）、セグメント利益は27百万円（前年同四半期比39.0%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、11,862百万円（前連結会計年度末は11,049百万円）となり、前連結会計年度末と比較して812百万円増加いたしました。これは主に、棚卸資産の増加によるものであります。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、8,665百万円（前連結会計年度末は7,228百万円）となり、前連結会計年度末と比較して1,437百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金、前受金並びに短期借入金の増加によるものであります。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は、3,196百万円（前連結会計年度末は3,821百万円）となり、前連結会計年度末と比較して625百万円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による利益剰余金の減少によるものであります。

なお、これらの要因により、自己資本比率は26.9%（前連結会計年度末は34.6%）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第3四半期連結累計期間につきましては、上半期で影響を受けた一部の装置部材の調達難は解消したものの、設計において調達難の部材の代替品への切り替えのための設計変更や、新規設計が必要な受注の増加等から発生したボトルネックに起因した納期遅れが前回業績予想時には第3四半期に解消できる見込みでありましたが、新機種の開発負荷が増加した等の要因から解消できず、納期が例年よりさらに第4四半期に集中してしまいました。このため、本来第4四半期に予定された製品の納期も後ろ倒しせざるを得なくなっております。また、半導体価格の下落と米中貿易戦争の長期化懸念等により、新ラインの稼働や工場建設の延期が発生しており、納入の先送り要請が前回業績予想時に比して増加してきています。さらに第3四半期に想定した受注が前述の受注環境の悪化から予想を下回るとともに納期が翌期に回される受注が多く、このため売上は前回予想を下回る見込みとなりました。

また、売上の下回りとともに、納期の長期化により利益率の高い大型機の売上が、前回業績予想時よりも今期中に売上となる台数がさらに少なくなる見込みとなることから、利益も前回予想から下回る見込みとなりました。これらの状況を踏まえ、通期見直しを見直した結果、通期の業績予想を修正いたしました。

詳細については、本日（平成31年2月12日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,197,497	1,804,474
受取手形及び売掛金	2,918,434	2,627,861
商品及び製品	321,363	751,230
仕掛品	2,242,932	3,279,406
原材料及び貯蔵品	419,689	428,383
その他	68,975	93,141
貸倒引当金	△7,041	△6,181
流動資産合計	8,161,851	8,978,317
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	740,725	690,839
機械装置及び運搬具(純額)	361,776	312,021
土地	484,534	484,534
その他	223,075	341,935
有形固定資産合計	1,810,112	1,829,331
無形固定資産	111,459	124,615
投資その他の資産		
その他	969,888	933,252
貸倒引当金	△3,350	△3,350
投資その他の資産合計	966,538	929,902
固定資産合計	2,888,110	2,883,848
資産合計	11,049,962	11,862,166
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,767,880	2,035,512
短期借入金	3,016,000	3,430,000
1年内返済予定の長期借入金	159,600	270,600
未払法人税等	63,303	17,419
賞与引当金	124,571	78,001
製品保証引当金	70,008	45,742
前受金	247,328	734,643
その他	391,384	394,328
流動負債合計	5,840,077	7,006,247
固定負債		
長期借入金	477,500	769,050
退職給付に係る負債	680,740	655,105
その他	230,105	235,354
固定負債合計	1,388,345	1,659,509
負債合計	7,228,422	8,665,756

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,837,500	5,837,500
利益剰余金	△1,688,138	△2,223,072
自己株式	△101,247	△101,248
株主資本合計	4,048,113	3,513,178
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	25,131	△3,105
為替換算調整勘定	△252,752	△314,382
退職給付に係る調整累計額	1,046	718
その他の包括利益累計額合計	△226,573	△316,769
純資産合計	3,821,539	3,196,409
負債純資産合計	11,049,962	11,862,166

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)
売上高	7,849,246	6,562,265
売上原価	6,200,267	5,368,425
売上総利益	1,648,978	1,193,840
販売費及び一般管理費	1,741,256	1,743,424
営業損失(△)	△92,278	△549,583
営業外収益		
受取利息及び配当金	3,447	3,059
持分法による投資利益	—	22,265
為替差益	3,939	15,931
受取技術料	14,042	3,861
受取賃貸料	9,502	9,645
その他	23,452	21,156
営業外収益合計	54,384	75,919
営業外費用		
支払利息	57,313	58,880
持分法による投資損失	4,643	—
その他	2,839	4,017
営業外費用合計	64,795	62,897
経常損失(△)	△102,689	△536,561
特別利益		
固定資産売却益	7,667	44,548
受取保険料	—	30,000
特別利益合計	7,667	74,548
特別損失		
固定資産売却損	7	—
過年度決算訂正関連費用	166,652	—
損害賠償金	—	43,126
子会社清算損	—	3,365
特別損失合計	166,660	46,492
税金等調整前四半期純損失(△)	△261,682	△508,504
法人税、住民税及び事業税	21,297	13,989
法人税等調整額	9,497	12,440
法人税等合計	30,794	26,429
四半期純損失(△)	△292,476	△534,934
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△292,476	△534,934

(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)
四半期純損失(△)	△292,476	△534,934
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	14,960	△28,236
為替換算調整勘定	20,560	△44,358
退職給付に係る調整額	10,716	△328
持分法適用会社に対する持分相当額	6,514	△17,271
その他の包括利益合計	52,751	△90,195
四半期包括利益	△239,725	△625,129
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△239,725	△625,129

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計
	電子部品 組立装置	電子部品	その他(注)	
売上高				
外部顧客への売上高	6,670,416	857,885	320,944	7,849,246
セグメント間の内部売上高又は振替高	156	2,706	107,921	110,784
計	6,670,572	860,592	428,866	7,960,030
セグメント利益又はセグメント損失(△)	355,456	△70,991	45,166	329,631

(注) 「その他」の区分は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び該当差額の主要な内容(差額調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	329,631
セグメント間取引高消去	—
全社費用(注)	△421,909
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△92,278

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計
	電子部品 組立装置	電子部品	その他(注)	
売上高				
外部顧客への売上高	5,248,776	896,818	416,670	6,562,265
セグメント間の内部売上高又は振替高	181	4,091	16,860	21,133
計	5,248,958	900,910	433,530	6,583,399
セグメント利益又はセグメント損失(△)	△65,776	△55,734	27,571	△93,939

(注) 「その他」の区分は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び該当差額の主要な内容(差額調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	△93,939
セグメント間取引高消去	—
全社費用(注)	△455,644
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△549,583

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

(参考資料)

受注及び販売の状況

当第3四半期連結累計期間(自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)の受注及び販売の実績は次のとおりです。

(1)受注実績

セグメントの名称	受注高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
電子部品組立装置	6,791,390	84.2	110.1
電子部品	931,707	11.6	107.1
その他	342,023	4.2	60.8
合計	8,065,121	100.0	106.1

(2)受注残実績

セグメントの名称	受注残高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
電子部品組立装置	5,246,108	95.3	90.5
電子部品	165,599	3.0	131.4
その他	90,537	1.7	24.0
合計	5,502,245	100.0	87.4

(注) 当第3四半期連結期間の末日の受注残高

(3)販売実績

セグメントの名称	販売高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
電子部品組立装置	5,248,776	80.0	78.7
電子部品	896,818	13.7	104.5
その他	416,670	6.3	129.8
合計	6,562,265	100.0	83.6